

GAP-251R - Serie G7 WORKSTATION RUGGED 2U

Intel® Xeon® E-2200/2100, Intel® 8^a/9^a Gen. Core™ i3 - Coffee Lake
I/O Motherboard e Alimentatore Posteriore



GAP è una linea di server e workstation rugged realizzati in alluminio, progettati per applicazioni che richiedono un apparato robusto e qualificato, adatto a operare in ambienti critici.

Le workstation rugged GAP-251R serie G7 integrano singolo processore Intel® Xeon® E-2200/2100 oppure Intel® 8th/9th Gen. Core® i3 (Coffee Lake) che offrono fino a 8 Core (16 Core logici grazie alla tecnologia Hyper-Threading), 16MB di Smart Cache, supporto per memorie DDR4 2666MHz con o senza ECC, fino a 128GB e 16 lane PCIe 3.0. I servizi di IPMI supportati consentono il controllo locale e remoto dei dispositivi integrati e permettono la segnalazione di allarmi e l'intervento immediato in caso di criticità.

GAP-251R è progettato per montaggio a rack 19", è caratterizzato da 2U di altezza e 510mm di profondità. La configurazione con I/O motherboard e alimentatore posteriori può ospitare dodici SSD estraibili e un DVD slim.

Le workstation rugged serie GAP-251R possono integrare fino a due schede PCIe Full size e due schede PCIe Low Profile. Le schede aggiuntive possono essere provviste di sistemi di fissaggio dedicati per garantire il funzionamento ottimale anche in presenza di shock e vibrazioni o durante il trasporto.

Le workstation rugged GAP sono conformi alle MIL-STD-810F per temperatura e shock, alle MIL-STD-167-1A per vibrazioni e opzionalmente alle normative MIL-STD-461. Su richiesta gli I/O e l'ingresso di alimentazione possono essere dotati di connettori MIL-GRADE.

Tutte le configurazioni sono accompagnate da inventory list per garantire il controllo della configurazione e la riproducibilità nel tempo. Su richiesta gli apparati integrati possono essere sottoposti a specifici profili di stress termico o meccanico.

CARATTERISTICHE

- Workstation Rugged 2U - 510mm profondità
- Singolo processore
- Intel® Xeon® serie E-2200/2100
- Intel® 8^a/9^a Gen. Core™ i3
- I/O motherboard posteriori
- Ingresso di alimentazione posteriore
- Alimentatore Ridondato AC o DC
- Fino a 12 SSD Hot Swap
- DVD opzionale
- Fino a 3 schede PCIe
- Conformal Coating opzionale
- MIL-STD-810G
- MIL-STD-461 opzionale

Specifiche Tecniche

Sistema

Processore	Intel® Xeon® E-2200/2100, Intel® 8a/9a Gen. Core™ i3 (fino a 95W TDP) – singolo socket H4 (LGA 1151)
Memoria	Fino a 128GB ECC UDIMM, DDR4-2600MHz
Chipset	Intel® C246
Porte rete	2 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x RJ45 dedicata IPMI
Storage	2.5" SATA Disk - RAID 0, 1, 5, 10
SATA	6 porte SATA3 (6Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
TPM	1 TPM Header
I/O motherboard	Disponibili sul retro: 1 x VGA, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1, 1 x COM, 2 x LAN, 1 x IPMI
Schede aggiuntive	2x schede PCIe - Bracket Full Height 1x scheda PCIe - Low Profile
Sistemi operativi	Windows® Server 2012 R2; Windows® Server 2016; Windows® Server 2019; Ubuntu 18.04 LTS; CentOS 7.5; Windows® 10 64bit
IPMI	IPMI2.0, SPM, Watchdog; notifica degli allarmi via SNMP ed e-mail
Monitoraggio remoto	Controllo delle funzionalità di sistema (velocità ventole, temperature, tensioni, alimentazione, consumi, stato dei dischi, stato delle memorie e della configurazione RAID)

Alimentazione

Alimentatore	100/240 VAC Ridonato 18-36 VDC Singolo o Ridonato 36-72 VDC Singolo o Ridonato
---------------------	--

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni	483 x 88 x 510 mm
Materiale	Alluminio con trattamento di passivazione superficiale
Colore	Silver
Alloggiamento	Chassis 2U per montaggio a rack 19" Guide telescopiche opzionali
Configurazione	I/O motherboard e alimentatore posteriori
Pannello frontale	Led: Led Power ON e funzionalità HDD/SSD; Pulsanti: Power ON / OFF e System Reset; Connettori: 2 x USB 2.0
Baie Drive	1 x 5.25" slim; 4 x baia 3.5" + 1 x baia interna x 3 ODD 2.5"

Parametri Ambientali - (Design to meet)

Temperatura operativa	Standard: 0°C / +50°C Estesa: -20°C / +60°C (in funzione delle configurazioni)
Umidità operativa	Da 8% a 95% non-condensata (in funzione delle configurazioni)
Temperatura storage	-40°C / +70°C
Vibrazioni	MIL-STD-810G, Method 514.7, Cat 4 - Proc. I - 2.24 Grms, 5-500 Hz 60 min/axis for 3 axes
Shock operativo	MIL-STD-810G Proc. I Method 516.7 - 15g / 11ms – half sine
Shock trasporto	MIL-STD-810G Proc. II Method 516.7 - 30g / 9ms sawtooth
Certificazioni	Direttiva 2014/35/UE-LVD / Direttiva 2014/30/UE-EMC Direttiva 2011/65/UE - RoHS / Regolamento (EC) No 1907/2006 - REACH

I server e le workstation GAP sono progettati in conformità alle specifiche ambientali indicate. Alcuni parametri dipendono dalla configurazione. Gli apparati possono essere sottoposti a profili di prova dedicati.